

Klebstoffe
Tieftemperaturbeständig hemikalien-/lösungsmittelresistent

Produktübersicht und - vergleich														
Produktübersicht und - vergleich Bezeichnung Basis-System Übliche Anwendung Broduktübersicht und - vergleich Bezeichnung Basis-System Übliche Anwendung Broduktübersicht und - vergleich Broduktubersicht und - vergleich Broduktubersicht u														
Bezeichnung	Basis-System	Übliche Anwendung	[F/e,		\(\frac{\gamma}{5}\)		\(\frac{1}{2}\)	Farbgebung	Viskosität 	Mischverh. /Topfzeit	Zugscher- festigkeit	Wärmeform- beständigkeit	Shore- Härte A	Aushärtung
SurABond [®] HH 061 F	2-komponenten Epoxidklebstoff	für die elektrisch leit- fähige Verklebung von mikro-/elektro- nischen Schaltkreisen und Sensoren	x	x	x	x	x	silberglänzend	gefüllt	Harz : Härter 1,00 : 0,45 ca. 2 Std.	~ 50 N/mm²	-196 °C bis +140 °C	-	RT-/thermischhärtend (RT: 24 Std., 80°C: 2 Std.
SurABond® HS 25-1	2-komponenten Epoxidklebstoff	für die klima- sowie feuchtestabile, insbe sondere tieftempera- turstabile und -flexible Verklebung von Kryo- bauelementen		x	x	х	х	weiß	A: ~ 140 Pa·s bei 0,5 s-1 ~ 85 Pa·s bei 25 s-1 B: ~ 25 mPa·s	1,000 : 0,111 ca. 90 min.	~ 50 N/mm²	-196 °C bis +160 °C	-	thermischhärtend (~ 60 min. bei 50 °C, ~ 30 min. bei 80 °C)